Our File No. 9281-4747 Client Reference No. N US03002

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re A	Application of:)
Naoya Hasegawa et al.)
Serial	No. To Be Assigned)
Filing Date: Herewith)
For:	Spin-Valve Magnetoresistive Element Having Fixed Magnetic Layer of Epitaxial Laminate Including Magnetic Layer and Nonmagnetic Layer)

SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

Mail Stop Patent Application Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Transmitted herewith is a certified copy of priority document Japanese Patent Application No. 2003-048694 filed on February 26, 2003 for the above-named U.S. application.

Respectfully submitted,

Gustavo Siller, Jr.

Registration No. 32,305 Attorney for Applicants Customer Number 00757

BRINKS HOFER GILSON & LIONE P.O. BOX 10395 CHICAGO, ILLINOIS 60610 (312) 321-4200

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 2月26日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-048694

[ST. 10/C]:

[JP2003-048694]

出 願 人
Applicant(s):

アルプス電気株式会社

2003年 8月14日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



【書類名】 特許願

【整理番号】 021308AL

【提出日】 平成15年 2月26日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 43/08

【発明の名称】 磁気検出素子

【請求項の数】 17

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会

社内

【氏名】 長谷川 直也

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会

社内

【氏名】 梅津 英治

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会

社内

【氏名】 斎藤 正路

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会

社内

【氏名】 井出 洋介

【特許出願人】

【識別番号】 000010098

【氏名又は名称】 アルプス電気株式会社

【代表者】 片岡 政隆

【代理人】

【識別番号】

100085453

【弁理士】

【氏名又は名称】

野▲崎▼ 照夫

【選任した代理人】

【識別番号】

100121049

【弁理士】

【氏名又は名称】 三輪 正義

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

041070

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 磁気検出素子

【特許請求の範囲】

【請求項1】 固定磁性層とフリー磁性層が非磁性材料層を介して積層されている磁気検出素子において、

前記固定磁性層は、複数の磁性層が非磁性中間層を介して積層されたものであって、前記複数の磁性層のうち前記非磁性材料層から最も離れた位置に形成されている第1の磁性層が、PtMn合金、または、X-Mn(ただしXは、Pt,Pd,Ir,Rh,Ru,Os,Ni,Feのいずれか1種または2種以上の元素である)合金からなる非磁性金属層に接しており、前記非磁性金属層内の結晶と前記第1の磁性層内の結晶はエピタキシャルまたはヘテロエピタキシャルな状態であり、前記固定磁性層の記録媒体との対向面側の端面が開放されていることを特徴とする磁気検出素子。

【請求項2】 前記非磁性金属層は、前記固定磁性層の第1の磁性層側の界面付近あるいは全領域において面心立方格子(fcc)構造をとり、前記界面と平行な方向に、{111}面として表される等価な結晶面が優先配向している請求項1記載の磁気検出素子。

【請求項3】 前記非磁性金属層の膜厚は、5 Å以上5 0 Å以下である請求項1または2記載の磁気検出素子。

【請求項4】 前記PtMn合金中のPt含有量、または、X-Mn合金中のX元素の含有量は、55原子%以上99原子%以下である請求項1ないし3のいずれかに記載の磁気検出素子。

【請求項5】 前記フリー磁性層と前記固定磁性層の両側端部には、フリー磁性層に縦バイアス磁界を供給するバイアス層が設けられている請求項1ないし4のいずれかに記載の磁気検出素子。

【請求項6】 前記固定磁性層の第1の磁性層は、前記非磁性金属層側の界面付近あるいは全領域において面心立方格子(fcc)構造をとり、前記界面と平行な方向に、{111}面として表される等価な結晶面が優先配向している請求項1ないし5のいずれかに記載の磁気検出素子。

【請求項7】 前記固定磁性層の第1の磁性層は、Costcut Cox Fey ($y \le 20$, x + y = 100) からなる請求項6に記載の磁気検出素子。

【請求項8】 前記固定磁性層の第1の磁性層は、前記非磁性金属層側の界面付近あるいは全領域において体心立方格子(bcc)構造をとり、前記界面と平行な方向に、{110}面として表される等価な結晶面が優先配向している請求項1ないし5のいずれかに記載の磁気検出素子。

【請求項9】 前記固定磁性層の第1の磁性層は、 Co_xFe_y ($y \ge 20$, x + y = 100)からなる請求項8記載の磁気検出素子。

【請求項10】 前記固定磁性層の第1の磁性層の、前記非磁性金属層側の界面付近は面心立方格子(fcc)構造をとり、前記界面と平行な方向に、{111}面として表される等価な結晶面が優先配向しており、前記非磁性中間層側の界面付近は体心立方格子(bcc)構造をとり、前記界面と平行な方向に、{110}面として表される等価な結晶面が優先配向している請求項1ないし5のいずれかに記載の磁気検出素子。

【請求項11】 前記固定磁性層の第1の磁性層の、前記非磁性金属層側の界面付近の組成は Co_xFe_y ($y \le 20$ x+y=100)またはCoであり、前記非磁性中間層側の界面付近の組成は Co_xFe_y ($y \ge 20$ x+y=100)である請求項10記載の磁気検出素子。

【請求項12】 前記固定磁性層の第1の磁性層は、前記非磁性金属層側の界面から前記非磁性中間層側の界面に向かうに連れて、Fe濃度が徐々に大きくなる請求項11記載の磁気検出素子。

【請求項13】 前記界面と平行な面内における、前記非磁性金属層の最近接原子間距離と、前記固定磁性層の第1の磁性層の最近接原子間距離の差を、前記第1の磁性層の最近接原子間距離で割った値が、0.05以上0.20以下である請求項1ないし12のいずれかに記載の磁気検出素子。

【請求項14】 前記第1の磁性層は磁歪定数が正の値である磁性材料によって形成されている請求項1ないし13のいずれかに記載の磁気検出素子。

【請求項15】 フリー磁性層、非磁性材料層、及び前記固定磁性層の両側 部には、Cr、α-Ta、またはRhからなる電極層が形成されている請求項1 ないし14のいずれかに記載の磁気検出素子。

【請求項16】 前記電極層の結晶格子面の膜面平行方向の面間隔がCrの場合で0.2044nm以上(bcc構造の {110} 面間隔)、α-Taの場合で0.2337nm以上(bcc構造の {110} 面間隔)、Rhの場合で0.2200nm以上(fcc構造の {111} 面間隔)である請求項15記載の磁気検出素子。

【請求項17】 前記固定磁性層の光学的トラック幅寸法が、0.15μm 以下である請求項1ないし16のいずれかに記載の磁気検出素子。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、フリー磁性層、非磁性材料層、固定磁性層を有する磁気検出素子に係り、特に固定磁性層自体の一軸異方性によって固定磁性層の磁化を固定する磁気検出素子に関する。

[0002]

【従来の技術】

磁気記録再生装置に搭載されている磁気ヘッドの現在の主流は、巨大磁気抵抗(GMR)効果を応用したスピンバルブ型磁気検出素子を用いたものである。

[0003]

スピンバルブ型磁気検出素子は、固定磁性層と呼ばれる強磁性膜とフリー磁性層と呼ばれる強磁性軟磁性膜が、非磁性材料層と呼ばれる非磁性膜を介して積層されたものである。

[0004]

フリー磁性層の磁化は、硬磁性体からなるハードバイアス層などからの縦バイアス磁界によって一方向に揃えられる。そして記録媒体からの外部磁界に対し、フリー磁性層の磁化が感度良く変動する。一方、前記固定磁性層の磁化は、前記フリー磁性層の磁化方向と交叉する方向に固定されている。

[0005]

フリー磁性層の磁化方向の変動と、固定磁性層の固定磁化方向との関係で電気

抵抗が変化し、この電気抵抗値の変化に基づく電圧変化または電流変化により、 記録媒体からの洩れ磁界が検出される。

[0006]

従来、前記固定磁性層を、PtMnなどの反強磁性材料からなる反強磁性層に 重ねて形成し、前記固定磁性層と前記反強磁性層との間に交換結合磁界を発生さ せることによって、前記固定磁性層の磁化を固定させていた。

[0007]

反強磁性層と固定磁性層との界面に発生する交換結合磁界は、製造工程中の磁界印加や記録媒体からの洩れ磁界による固定磁性層の磁化方向の変動を防ぐことができる程度に充分大きくできる。また、反強磁性層自体は、外部に磁場を発生させないため、磁気検出素子の設計が容易になるという利点を有していた。

[0008]

しかし、前記反強磁性層と前記固定磁性層の界面に充分な大きさの交換結合磁界を発生させるためには、前記反強磁性層の膜厚を200Å程度にする必要があった。

[0009]

磁気検出素子を構成する積層体の中に存在する、膜厚の大きい反強磁性層は、センス電流の分流損失の主な原因となる。記録媒体の高記録密度化に対応するためには、磁気検出素子の出力を向上させることが必要であるが、上述したセンス電流の分流損失は磁気検出素子の出力向上の妨げになる。

[0010]

また、磁気検出素子の上下には、検出対象の記録信号を効率的に読み取るために、軟磁性材料からなるシールド層が設けられる。記録媒体の高線記録密度化に対応するためには、上下のシールド層間距離を短くする必要がある。膜厚の大きな前記反強磁性層は、上下のシールド層間距離を短くするときの妨げにもなっていた。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

そこで、図14に示されるように、反強磁性層を省略し、固定磁性層自体の一軸異方性によって固定磁性層の磁化を固定する磁気検出素子が提案された。

[0012]

図14に、示される磁気検出素子は、アルミナなどの絶縁材料からなる下部ギャップ層1上に、下から順に下地層2、第1の磁性層3aと第2の磁性層3cが、非磁性中間層3bを介して積層された人工フェリ構造の固定磁性層3、非磁性材料層4、フリー磁性層5、保護層6からなる多層膜Tの両側7,7にバイアス下地層8,8、ハードバイアス層9,9、電極層10,10が形成されている。

[0013]

図14に示される磁気検出素子は、固定磁性層3に重なる反強磁性層が形成されておらず、固定磁性層3自体の一軸異方性によって固定磁性層の磁化が図示Y方向に固定されている。従って、反強磁性層を有する従来の磁気検出素子に比べて分流損失を少なくできるので、磁気検出素子の磁界検出出力を20~30%向上させることができる。また、磁気検出素子の上下に設けられるシールド層間の距離も短くなるので、記録媒体のさらなる高線記録密度化に対応することもできる。

[0014]

図14に示されるような磁気検出素子は、以下に示す特許文献1及び特許文献 2に記載されている。

[0015]

【特許文献1】

特開平8-7235号公報(第8頁、第9頁、第5図)

【特許文献2】

特開2000-113418号公報(第7頁、第8頁、図4、図5、図6 、図7)

[0016]

【発明が解決しようとする課題】

特許文献1に記載されている磁気検出素子は、タンタル(Ta)からなるバッファ層62を下地として、その上に、ピン止め強磁性層70が積層されたものである。ピン止め強磁性層70は、第1のコバルト(Co)フィルム72と第2のコバルト(Co)フィルム74が、ルテニウム(Ru)フィルム73を介して積

層されたものである。第1のコバルト(Co)フィルム72と第2のコバルト(Co)フィルム74は各々の異方性磁界によって磁化が固定されている。第1のコバルト(Co)フィルム72と第2のコバルト(Co)フィルム74は反強磁性結合しており、互いに反平行方向に磁化されている。

$[0\ 0\ 1\ 7]$

しかし、特許文献1に記載されている磁気検出素子のように、タンタルからなるバッファ層上にCoフィルムを積層する構成では、ピン止め強磁性層70の磁化方向を適切に固定できないことがわかった。このことは、特許文献2においても指摘されている。

[0018]

特許文献2に記載の磁気検出素子は、特許文献1の問題を解決することを目的として発明されたものである。この磁気検出素子では、積層フェリ固定層の強磁性膜をCoFeNiによって形成することによって誘導異方性を向上させている。

[0019]

なお、特許文献 2 には、積層フェリ固定層の下にTaからなる下地層を設けることも記載されているが、Ta下地を設けた場合とTa下地を設けない場合を比較した実験結果(特許文献 2 の図 4 、図 5 、図 6 、図 7)をみると、強磁性層にCoFe合金を用いたときには、Ta下地を設けない方が磁気抵抗変化も保磁力も大きくなることが示されている。

[0020]

特許文献2には、積層フェリ固定層の誘導異方性を大きくするために、強磁性膜にCoFe合金を使用すること、及び強磁性膜の磁歪を正にすることが記載されている。

[0021]

自己固定式の固定磁性層の磁化を固定するために、最も重要な要素は固定磁性層の磁気弾性エネルギーに由来する一軸異方性である。特に固定磁性層の磁歪を最適化することが重要である。しかし、特許文献2には、固定磁性層の磁歪を最適化する機構に関する考察がなく、固定磁性層の磁歪を最適化するための具体的

構成に関する記載はなされていない。

[0022]

本発明は、上記従来の課題を解決するためのものであり、自己固定式の固定磁性層を有する磁気検出素子において、固定磁性層の磁歪を制御する機構を明らかにし、該磁歪を適切に制御するために、前記固定磁性層に接する非磁性膜の材料を適切に選択することによって、固定磁性層の磁化を強固に固定することのできる磁気検出素子を提供することを目的とする。

[0023]

【課題を解決するための手段】

本発明は、固定磁性層とフリー磁性層が非磁性材料層を介して積層されている 磁気検出素子において、

前記固定磁性層は、複数の磁性層が非磁性中間層を介して積層されたものであって、前記複数の磁性層のうち前記非磁性材料層から最も離れた位置に形成されている第1の磁性層が、PtMn合金、または、X-Mn(ただしXは、Pt,Pd,Ir,Rh,Ru,Os,Ni,Feのいずれか1種または2種以上の元素である)合金からなる非磁性金属層に接しており、前記非磁性金属層内の結晶と前記第1の磁性層内の結晶はエピタキシャルまたはヘテロエピタキシャルな状態であり、前記固定磁性層の記録媒体との対向面側の端面が開放されていることを特徴とするものである。

[0024]

本発明は、固定磁性層自体の一軸異方性によって固定磁性層の磁化が固定される、いわゆる自己固定式の磁気検出素子である。

[0025]

従って、膜厚200Åの厚い反強磁性層を有する磁気検出素子に比べて分流損失を少なくできるので、磁気検出素子の磁界検出出力を20~30%向上させることができる。また、磁気検出素子の上下に設けられるシールド層間の距離も短くなるので、記録媒体のさらなる高線記録密度化に対応することもできる。

[0026]

強磁性体膜の磁気異方性磁界を決める要素には、結晶磁気異方性、誘導磁気異

方性、及び磁気弾性効果がある。このうち、結晶磁気異方性は多結晶をランダムに配向した結晶を有する膜では、異方性を一軸にそろえるのは難しい。一方、誘導磁気異方性は成膜時または熱処理時に一方向の磁場を与えることによって一軸性を帯び、磁気弾性効果は一軸性の応力を加えることによって一軸性を帯びる。

[0027]

本発明は、固定磁性層の磁化を固定する一軸異方性を決める、誘導磁気異方性と磁気弾性効果のうち、磁気弾性効果に着目してなされたものである。

[0028]

磁気弾性効果は、磁気弾性エネルギーに支配される。磁気弾性エネルギーは、 固定磁性層にかかる応力と固定磁性層の磁歪定数によって規定される。

[0029]

本発明では、前記固定磁性層の記録媒体との対向面側の端面が開放されている ので、応力の対称性がくずれて、前記固定磁性層には、素子高さ方向(ハイト方 向;前記対向面に対する法線方向)に引張り応力が働く。

[0030]

本発明では、固定磁性層の磁歪定数を大きくすることによって磁気弾性エネルギーを大きくし、これによって、固定磁性層の一軸異方性を大きくするものである。固定磁性層の一軸異方性が大きくなると、固定磁性層の磁化は一定の方向に強固に固定され、磁気検出素子の出力が大きくなりかつ出力の安定性や対称性も向上する。

[0031]

具体的には、前記固定磁性層を構成する前記複数の磁性層のうち前記第1の磁性層を、PtMn合金、または、X-Mn(ただしXは、Pt, Pd, Ir, Rh, Ru, Os, Ni, Fe のいずれか1種または2種以上の元素である)合金からなる非磁性金属層と、エピタキシャルまたはヘテロエピタキシャルな状態で接合させることによって、前記第1の磁性層の結晶構造に歪みを生じさせて前記第1の磁性層の磁歪定数 λ を大きくさせている。

[0032]

前記非磁性金属層が、PtMn合金、または、X―Mn(ただしXは、Pt,

Pd, Ir, Rh, Ru, Os, Ni, Feのいずれか1種または2種以上の元素である)合金によって形成されると、前記非磁性金属層は、前記固定磁性層の第1の磁性層側の界面付近、あるいは全領域において、面心立方格子(fcc)構造をとり、前記非磁性金属層の下にNiFeCrなどの適切なシード層を配した場合に、前記界面と平行な方向に、 $\{1\ 1\ 1\}$ 面として表される等価な結晶面が優先配向する。

[0033]

前記非磁性金属層の膜厚は、5Å以上50Å以下であることが好ましい。

PtMn合金、または、X-Mn(ただしXは、Pt,Pd,Ir,Rh,Ru,Os,Ni,Feのいずれか1種または2種以上の元素である)からなる前記非磁性金属層の膜厚がこの範囲内であると、非磁性金属層の結晶構造は、成膜時の状態である面心立方構造(fcc)を維持しつづける。なお、前記非磁性金属層の膜厚が、50 Åより大きくなると、250 $\mathbb C$ 以上の熱が加わったときに、非磁性金属層の結晶構造が $\mathbb C$ uAuI型の規則型の面心正方構造(fct)に構造変態するので好ましくない。ただし、非磁性金属層の膜厚が、50 Åより大きくても、250 $\mathbb C$ 以上の熱が加わらなければ、非磁性金属層の結晶構造は、成膜時の状態である面心立方構造(fcc)を維持しつづける。

[0034]

なお、PtMn合金、または、X-Mn(ただしXは、Pt, Pd, Ir, Rh, Ru, Os, Ni, Fe のいずれか1種または2種以上の元素である)からなる前記非磁性金属層が面心立方構造(fcc) の結晶構造を有するとき、この非磁性金属層と前記第1磁性層との界面には交換結合磁界は発生しないか、または極めて弱く、交換結合磁界によって前記第1磁性層の磁化方向を固定することはできない。

[0035]

また、前記PtMn合金中のPt含有量、または、X-Mn合金中のX元素の含有量が、55原子%以上99原子%以下であると、前記第1磁性層の磁歪を大きくすることができるので好ましい。

[0036]

なお、Pt100at%でも、磁歪を大きくすることは可能である。しかし、Pt100at%だと、抵抗値が小さくなりセンス電流の分流損失が大きくなって出力が低下しやすい。したがって、Mnを1%以上添加して比抵抗を大きくするすることが好ましい。

[0037]

前記フリー磁性層と前記固定磁性層の両側端部には、フリー磁性層に縦バイアス磁界を供給するバイアス層が設けられていることが好ましい。

[0038]

本発明では、前記固定磁性層の第1の磁性層は、前記非磁性金属層側の界面付近あるいは全領域において面心立方格子(fcc)構造をとり、前記界面と平行な方向に、{111}面として表される等価な結晶面が優先配向していることが好ましい。

[0039]

上述のごとく、本発明における前記非磁性金属層は、fcc構造をとり前記界面と平行な方向に、{111}面として表される等価な結晶面が優先配向しているものである。

[0040]

従って、前記第1の磁性層が、fcc構造をとり前記界面と平行な方向に、{ 111 | 面として表される等価な結晶面が優先配向しているものであると、前記 第1の磁性層を構成する原子と前記非磁性金属層を構成する原子が互いに重なり あいやすくなる。

[0041]

しかし、前記第1の磁性層の | 1 1 1 | 面内の最近接原子間距離と、前記非磁性 金属層の | 1 1 1 | 面内の最近接原子間距離には、一定以上の差が生じるので、前 記第1の磁性層と前記非磁性金属層の界面付近では、前記第1の磁性層を構成する原子と前記非磁性金属層を構成する原子が互いに重なり合いつつも、それぞれ の結晶構造に歪みが生じている。すなわち、前記第1の磁性層の結晶構造に歪を 生じさせることによって磁歪定数 λ を大きくさせることができる。

[0042]

例えば、前記固定磁性層の第1の磁性層を、CostatCoxFey ($y \le 2$ 0, x + y = 100、x及びyはat%) によって形成すると、前記第1の磁性層を、fcc構造をとり前記界面と平行な方向に $\{1111\}$ 面として表される等価な結晶面が優先配向するものにできる。

[0043]

または、前記固定磁性層の第1の磁性層は、前記非磁性金属層側の界面付近あるいは全領域において体心立方格子(bcc)構造をとり、前記界面と平行な方向に、 $\{110\}$ 面として表される等価な結晶面が優先配向しているものであることが好ましい。

[0044]

前記第1の磁性層が、bcc構造をとり前記界面と平行な方向に、{1110}面として表される等価な結晶面が優先配向しているものであっても、前記第1の磁性層を構成する原子と前記非磁性金属層を構成する原子が互いに重なりあいやすくなる。

[0045]

このときも、前記第1の磁性層の {110} 面内の最近接原子間距離と、前記非磁性金属層の {111} 面内の最近接原子間距離には、一定以上の差が生じ、前記第1の磁性層と前記非磁性金属層の界面付近では、前記第1の磁性層を構成する原子と前記非磁性金属層を構成する原子が互いに重なり合いつつも、それぞれの結晶構造に歪みが生じる。すなわち、前記第1の磁性層の結晶構造に歪を生じさせることによって磁歪定数 λ を大きくさせることができる。

[0046]

例えば、前記固定磁性層の第1の磁性層を、 Co_xFe_y ($y \ge 20$, x+y=100, x及びyはat%)によって形成すると、前記第1の磁性層を、bcc構造をとり前記界面と平行な方向に $\{110\}$ 面として表される等価な結晶面が優先配向するものにできる。なお、bcc構造をとる Co_xFe_y ($y \ge 20$, x+y=100)は、fcc構造をとる Co_xFe_y ($y \le 20$, x+y=100)より、特にy=50付近で、磁歪定数 λ の値が大きいので、より大きな磁気弾性効果を発揮することができる。また、bcc構造をとる Co_xFe

y ($y \ge 20$, x + y = 100) は、保磁力が大きく、前記固定磁性層の磁化固定を強固にすることができる。

[0047]

また、本発明では、前記固定磁性層の第1の磁性層の、前記非磁性金属層側の 界面付近は面心立方格子(fcc)構造をとり、前記界面と平行な方向に{11 1}面として表される等価な結晶面が優先配向しており、前記非磁性中間層側の 界面付近は体心立方格子(bcc)構造をとり、前記界面と平行な方向に、{1 10}面として表される等価な結晶面が優先配向していることが好ましい。

[0048]

前記非磁性中間層側の界面付近を b c c 構造にすることにより、磁歪定数 λ の値を大きくし、大きな磁気弾性効果を発揮させることができる。一方、前記第 1 の磁性層の前記非磁性金属層側の界面付近を f c c 構造にすると、固定磁性層、非磁性材料層、フリー磁性層の結晶配向性が一定になりやすく、磁気抵抗変化率 (MR比)を高くすることができる。

[0049]

例えば、前記固定磁性層の第1の磁性層の、前記非磁性金属層側の界面付近の組成を Co_xFe_y ($y \le 20$, x+y=100)または Co_xFe_y ($y \ge 20$, x+y=100)にする中間層側の界面付近の組成を Co_xFe_y ($y \ge 20$, x+y=100)にすることによって、前記非磁性金属層側の界面付近は、 f_cc 構造であって、前記界面と平行な方向に $\{111\}$ 面として表される等価な結晶面が優先配向し、前記非磁性中間層側の界面付近は、(b_cc)構造であって、前記界面と平行な方向に、 $\{110\}$ 面として表される等価な結晶面が優先配向しているものにできる。

[0050]

また、前記非磁性中間層側の界面付近の組成が、 Co_XFe_y ($y \ge 20$, x + y = 100)であると、前記非磁性中間層を介した第1の磁性層と他の磁性層間のRKKY相互作用が強くなるので好ましい。

$[0\ 0\ 5\ 1]$

なお、前記固定磁性層の第1の磁性層は、前記非磁性金属層側の界面から前記 非磁性中間層側の界面に向かうに連れて、Fe濃度が徐々に大きくなるものであ ってもよい。

[0052]

本発明では、前記非磁性金属層を構成する原子と前記第1の磁性層の原子とを、重なり合わせつつ、結晶構造に歪みを生じさせるために、前記界面と平行な面内における、前記非磁性金属層の最近接原子間距離と、前記固定磁性層の第1の磁性層の最近接原子間距離の差を、前記第1の磁性層の最近接原子間距離で割った値を、0.05以上0.20以下にすることが好ましい。

[0053]

また前記第1の磁性層は磁歪定数が正の値である磁性材料によって形成されていることが好ましい。

[0054]

なお、フリー磁性層、非磁性材料層、及び前記固定磁性層の両側部に、Cr、 $\alpha-Ta$ 、またはRhからなる電極層が形成されていると、前記固定磁性層にかかるトラック幅方向の圧縮応力(すなわちハイト方向の引張り応力)を大きくできるので好ましい。

[0055]

前記電極層の結晶格子面の膜面平行方向の面間隔がCrの場合で0.2044 nm以上(bcc構造の 1110 面間隔)、α-Taの場合で0.2337nm以上(bcc構造の 1110 面間隔)、Rhの場合で0.2200nm以上(fcc構造の 1111 面間隔)であることが好ましい。

[0056]

本発明は、磁気検出素子の小型化を進めたときに特に有効になる。特に、前記固定磁性層の光学的トラック幅寸法が、0.15 μ m以下であることが好ましい

[0057]

【発明の実施の形態】

図1は、本発明の第1の実施の形態の磁気検出素子を記録媒体との対向面側から見た断面図である。

[0058]

図1に示される磁気検出素子では、アルミナなどの絶縁性材料からなる下部ギャップ層20上に多層膜T1が形成されている。

[0059]

図1に示す実施形態では、多層膜T1は、下からシードレイヤ21、非磁性金属層22、固定磁性層23、非磁性材料層24、フリー磁性層25及び保護層26の順に積層されたものである。

[0060]

シードレイヤ21は、NiFe合金、NiFeCr合金あるいはCr、Taなどで形成されている。シードレイヤ21は、例えば(Ni $_0$. 8Fe $_0$. 2) 6 0 a t % Cr 4 0 a t % の膜厚 $_3$ 5 Å $_4$ 6 0 Å で形成される。

[0061]

シードレイヤ21があると、非磁性金属層22の{1111}配向が良好になる。 非磁性金属層22については、後述する。

[0062]

固定磁性層23は、第1磁性層(第1の磁性層)23aと第2磁性層23cが 非磁性中間層23bを介して積層された人工フェリ構造を有している。固定磁性 層23は、固定磁性層23自体の一軸異方性によって磁化が、ハイト方向(図示 Y方向)に固定されている。

[0063]

非磁性材料層 24 は、固定磁性層 23 とフリー磁性層 25 との磁気的な結合を防止する層であり、Cu, Cr, Au, Agなど導電性を有する非磁性材料により形成されることが好ましい。特にCuによって形成されることが好ましい。非磁性材料層の膜厚は17 Å ~ 30 Å である。

[0064]

フリー磁性層 25 は、N i F e 合金やC o F e 合金等の磁性材料で形成される。図 1 に示す実施形態では特にフリー磁性層 25 が N i F e 合金で形成されるとき、フリー磁性層 25 と非磁性材料層 24 との間にC o やC o F e などからなる拡散防止層(図示しない)が形成されていることが好ましい。フリー磁性層 25 の膜厚は 20 Å ~ 60 Å \sim 80 Å \sim 90 Å \sim 80 Å \sim 80 Å \sim 80 Å \sim 80 Å \sim 90 Å \sim

磁性中間層を介して積層された人工フェリ構造であってもよい。

[0065]

保護層 2 6 は T a などからなり、多層膜 T 1 の酸化の進行を抑える。保護層 2 6 の膜厚は 1 0 Å ~ 5 0 Å である。

[0066]

図1に示す実施形態では、シードレイヤ層21から保護層26までの多層膜T1の両側にはバイアス下地層27、ハードバイアス層28及び電極層29が形成されている。ハードバイアス層28からの縦バイアス磁界によってフリー磁性層25の磁化はトラック幅方向(図示X方向)に揃えられる。

[0067]

バイアス下地層 27, 27はCr、W、Tiで、ハードバイアス層 28, 28は例えばCo Pt (コバルトー白金) 合金やCo Pt (コバルトークロムー白金) 合金などで形成されており、電極層 29, 29は、Cr、Ta, Rh, Au Pw (タングステン) などで形成されている。

[0068]

バイアス下地層 2 7, 2 7の膜厚は 2 0 Å ~ 1 0 0 Å、ハードバイアス層 2 8, 2 8の膜厚は 1 0 0 Å ~ 4 0 0 Å、電極層 2 9, 2 9の膜厚は 4 0 0 Å ~ 1 5 0 0 Å である。

[0069]

電極層29,29、及び保護層26上には、アルミナなどの絶縁性材料からなる上部ギャップ層30が積層される。なお、図示はしないが、下部ギャップ層20の下には下部シールド層が設けられ、上部ギャップ層上には上部シールド層が設けられる。下部シールド層及び上部シールド層はNiFeなどの軟磁性材料によって形成される。上部ギャップ層及び下部ギャップ層の膜厚は50Å~300Åである。

[0070]

フリー磁性層 2 5 の磁化は、ハードバイアス層 2 8 , 2 8 からの縦バイアス磁界によってトラック幅方向(図示 X 方向)に揃えられる。そして記録媒体からの信号磁界(外部磁界)に対し、フリー磁性層 2 5 の磁化が感度良く変動する。一

方、固定磁性層23の磁化は、ハイト方向(図示Y方向)に固定されている。

[0071]

フリー磁性層 2 5 の磁化方向の変動と、固定磁性層 2 3 の固定磁化方向(特に第 2 磁性層 2 3 c の固定磁化方向)との関係で電気抵抗が変化し、この電気抵抗値の変化に基づく電圧変化または電流変化により、記録媒体からの洩れ磁界が検出される。

[0072]

本実施の形態の特徴部分について述べる。

図1に示される磁気検出素子の固定磁性層23は、第1磁性層(第1の磁性層)23aと第2磁性層23cが非磁性中間層23bを介して積層された人工フェリ構造を有している。第1磁性層23aの磁化と第2磁性層23cの磁化は、非磁性中間層23bを介したRKKY相互作用によって互いに反平行方向に向けられている。

[0073]

第1磁性層23 a は、第2磁性層23 c より非磁性材料層24から離れた位置に形成されており、非磁性金属層22 に接している。

[0074]

[0075]

非磁性金属層22の膜厚は、5Å以上50Å以下であることが好ましい。

PtMn合金、または、X-Mn(ただしXは、Pt,Pd,Ir,Rh,Ru,Os,Ni,Feのいずれか1種または2種以上の元素である)からなる非磁性金属層22の膜厚がこの範囲内であると、非磁性金属層22の結晶構造は、成膜時の状態である面心立方構造(fcc)を維持しつづける。なお、非磁性金属層22の膜厚が、50Åより大きくなると、250 $^{\circ}$ 以上の熱が加わったときに、非磁性金属層22の結晶構造がCuAuI型の規則型の面心正方構造(fct)に構造変態するので好ましくない。ただし、非磁性金属層22の膜厚が、5

0 Åより大きくても、250℃以上の熱が加わらなければ、非磁性金属層の結晶構造は、成膜時の状態である面心立方構造(fcc)を維持しつづける。

[0076]

PtMn合金、または、X—Mn(ただしXは、Pt, Pd, Ir, Rh, Ru, Os, Ni, Feのいずれか1種または2種以上の元素である)からなる非磁性金属層22が面心立方構造(fcc)の結晶構造を有するとき、この非磁性金属層22と第1磁性層23aとの界面には交換結合磁界は発生しないか、または極めて弱く、交換結合磁界によって第1磁性層23aの磁化方向を固定することはできない。

[0077]

従って、図1に示される磁気検出素子は、固定磁性層23自体の一軸異方性によって固定磁性層23の磁化が固定されている。図1に示される磁気検出素子は、自己固定式の磁気検出素子と呼ばれる。

[0078]

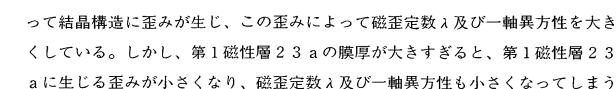
自己固定式の磁気検出素子は、200Å程度の厚い膜厚の反強磁性層を有する磁気検出素子に比べて分流損失を少なくできるので、磁気検出素子の磁界検出出力を20~30%向上させることができる。また、磁気検出素子の上下に設けられるシールド層間の距離も短くなるので、記録媒体のさらなる高線記録密度化に対応することもできる。

[0079]

本実施の形態では、第2磁性層23cの膜厚の方が、第1磁性層23aの膜厚より大きくなっている。第2磁性層23cの磁化はハイト方向(図示Y方向)を向き、第1磁性層23aの磁化はハイト方向と反平行方向を向いた状態で磁化が固定されている。

[0080]

第1磁性層 2 3 a の膜厚は 1 0 Å \sim 3 0 Å であり、第 2 磁性層 2 3 c の膜厚は 1 5 Å \sim 3 5 Å である。第 1 磁性層 2 3 a の膜厚を厚くすると、保磁力は大きくなる。しかし、第 1 磁性層 2 3 a の膜厚が大きいと分流損失が大きくなる。また、後述するように、第 1 磁性層 2 3 a は、非磁性金属層 2 2 と整合することによ



[0081]

本発明は、固定磁性層23の磁化を固定する一軸異方性を決める、誘導磁気異

方性と磁気弾性効果のうち、磁気弾性効果を主に利用している。

[0082]

磁気弾性効果は、磁気弾性エネルギーに支配される。磁気弾性エネルギーは、固定磁性層 23 にかかる応力 σ と固定磁性層 23 の磁歪定数 λ によって規定される。

[0083]

図2は、図1に示された磁気検出素子を図示上側(図示2方向と反対方向)からみた平面図である。磁気検出素子の多層膜T1は一対のバイアス下地層27,27、ハードバイアス層28,28及び電極層29,29の間に形成されている。なお、バイアス下地層27,27、ハードバイアス層28,28は、電極層29,29の下に設けられているので、図2には図示されていない。多層膜T1と、バイアス下地層27,27、ハードバイアス層28,28及び電極層29,29の周囲は、斜線で示される絶縁材料層31によって埋められている。

[0084]

また、多層膜T1、バイアス下地層27, 27、ハードバイアス層28, 28、及び電極層29, 29の記録媒体との対向面側の端面Fは露出しているか、またはダイヤモンドライクカーボン(DLC)などからなる膜厚20 Å ~ 50 Å薄い保護層で覆われているだけであり、開放端となっている。

[0085]

従って、もともと2次元的に等方的であった下部ギャップ層20及び上部ギャップ層30からの応力が端面Fで開放された結果、対称性がくずれて、多層膜T1には、ハイト方向(図示Y方向)に平行な方向に、引っ張り応力が加えられている。また、バイアス下地層27,27、ハードバイアス層28,28、及び電

極層29,29の積層膜が圧縮性の内部応力を有している場合には、電極層などが面内方向に延びようとするため、多層膜T1には、トラック幅方向に(図示X方向)に平行な方向及び反平行な方向に圧縮応力を加えられている。

[0086]

すなわち、記録媒体との対向面側の端面Fが開放されている固定磁性層23には、ハイト方向の引張り応力とトラック幅方向の圧縮応力が加えられる。そして、第1磁性層23aは、磁歪定数が正の値である磁性材料によって形成されているので、磁気弾性効果によって、第1磁性層23aの磁化容易軸は磁気検出素子の奥側(ハイト方向;図示Y方向)に平行方向となり、第1磁性層23aの磁化方向がハイト方向と平行方向または反平行方向に固定される。第2磁性層23cの磁化は、非磁性中間層23bを介したRKKY相互作用によって第1磁性層23aの磁化方向と反平行方向を向いた状態で固定される。

[0087]

本発明では、固定磁性層 2 3 の磁歪定数を大きくすることによって磁気弾性エネルギーを大きくし、これによって、固定磁性層 2 3 の一軸異方性を大きくするものである。固定磁性層 2 3 の一軸異方性が大きくなると、固定磁性層 2 3 の磁化は一定の方向に強固に固定され、磁気検出素子の出力が大きくなりかつ出力の安定性や対称性も向上する。

[0088]

具体的には、固定磁性層23を構成する第1磁性層23aを、非磁性金属層2 2と接合させることによって、第1磁性層23aの結晶構造に歪みを生じさせて 第1磁性層23aの磁歪定数 λを大きくさせている。

[0089]

先に述べたように、非磁性金属層 22 は、fc c 構造をとり、界面と平行な方向に $\{111\}$ 面として表される等価な結晶面が優先配向するものである。

[0090]

一方、固定磁性層 2 3 の第 1 磁性層 2 3 a が C o または C o x F e y ($y \le 2$ 0 , x+y=1 0 0)によって形成されていると、第 1 磁性層 2 3 a は面心立方格子(f c c)構造をとる。また、第 1 磁性層 2 3 a は、界面と平行な方向に、

|111||面として表される等価な結晶面が優先配向している。

[0091]

従って、第1磁性層23aを構成する原子と非磁性金属層22を構成する原子が互いに重なりあいやすくなり、非磁性金属層22内の結晶と固定磁性層23内の結晶はエピタキシャルな状態になっている。

[0092]

しかし、第1磁性層23aの{111}面内の最近接原子間距離と、非磁性金属層22の{111}面内の最近接原子間距離には、一定以上の差があることが必要である。

[0093]

非磁性金属層22を構成する原子と第1磁性層23aの原子とを重なり合わせつつ、結晶構造に歪みを生じさせ、第1磁性層23aの磁歪を大きくするために、非磁性金属層22の材料である前記PtMn合金中のPt含有量、または、X—Mn合金中のX元素の含有量を調節することが好ましい。

[0094]

例えば、前記PtMn合金中のPt含有量、または、X—Mn合金中のX元素の含有量を、51原子%以上にすると、非磁性金属層22に重なる第1磁性層23aの磁歪が急激に増加する。また、前記PtMn合金中のPt含有量、または、X—Mn合金中のX元素の含有量が、55原子%以上99原子%以下であると、前記第1磁性層の磁歪が大きな値をとりつつ安定する。

また、非磁性金属層 2 2 の {1 1 1 } 面内の最近接原子間距離と、固定磁性層 2 3 の第 1 磁性層 2 3 a の {1 1 1 } 面内の最近接原子間距離との差を、第 1 磁性層 2 3 a の {1 1 1 } 面内の最近接原子間距離で割った値(以下ミスマッチ値と呼ぶ)を、0.05以上0.20以下にすることが好ましい。

[0095]

本実施の形態の磁気検出素子では、図3に模式的に示すように、非磁性金属層22を構成する原子と第1磁性層23aの原子とが重なり合いつつも、界面付近で結晶構造に歪みが生じている状態になる。

[0096]

図3において符号N1は第1磁性層23aの{1111}面内の最近接原子間距離を示しており、符号N2は非磁性金属層22の{1111}面内の最近接原子間距離を示している。N1及びN2は、非磁性金属層22と第1磁性層23aの界面から離れた歪みの影響の少ないところで測定する。

[0097]

このように、第1磁性層23aの結晶構造に歪みが生じると、第1磁性層23aの磁歪定数 λを大きくすることができるので、大きな磁気弾性効果を発揮することができる。

[0098]

ここで、非磁性金属層 2 2 と第 1 磁性層 2 3 a のミスマッチ値が小さすぎると、図 4 に模式的に示すように、非磁性金属層 2 2 の原子と第 1 磁性層 2 3 a の原子が重なりあったとき、界面付近の結晶構造に歪みが生じなくなり、第 1 磁性層 2 3 a の磁歪定数 λ を大きくすることができなくなる。

[0099]

また、非磁性金属層 2 2 と第 1 磁性層 2 3 a のミスマッチ値が大きくなりすぎると、図 5 に模式的に示すように、非磁性金属層 2 2 の原子と第 1 磁性層 2 3 a の原子が重なりあわなくなり、非整合または非エピタキシャルな状態になる。非磁性金属層 2 2 の原子と第 1 磁性層 2 3 a の原子が非整合または非エピタキシャルな状態になるときも、界面付近の結晶構造に歪みが生じなくなり、第 1 磁性層 2 3 a の磁歪定数 λ を大きくすることができなくなる。

[0100]

また、固定磁性層23の第1磁性層23aが、体心立方格子(bcc)構造を とり、界面と平行な方向に、 {110}面として表される等価な結晶面が優先配向 しているものであってもよい。

[0101]

例えば、固定磁性層 2 3 の第 1 磁性層 2 3 a が C o $_x$ F e $_y$ ($y \ge 2$ 0, x + y = 1 0 0)によって形成されていると、第 1 磁性層 2 3 a は体心立方格子(b c c)構造をとる。

[0102]

上述したように、非磁性金属層22は、fcc構造をとり、界面と平行な方向に1111面として表される等価な結晶面が優先配向しているものである。

[0103]

bcc構造を有する結晶の {1110} 面として表される等価な結晶面の原子配列とfcc構造を有する結晶の {1111 面として表される等価な結晶面の原子配列は類似しており、bcc構造を有する結晶とfcc構造を有する結晶を、各々の原子が重なり合った整合状態、いわゆるヘテロエピタキシャルな状態にすることができる。

[0104]

さらに、第1磁性層23aの | 110 | 面内の最近接原子間距離と、非磁性金属層22の | 111 | 面内の最近接原子間距離には、一定以上の差が生じている。このため、第1磁性層23aと非磁性金属層22の界面付近では、第1磁性層23aを構成する原子と非磁性金属層22を構成する原子が互いに重なり合いつつも、それぞれの結晶構造に歪みが生じる。従って、第1磁性層23aの結晶構造に歪を生じさせることによって磁歪定数 λを大きくさせることができる。

[0105]

なお、b c c 構造をとる Co_xFe_y ($y \ge 20$, x+y=100)は、f c c 構造をとる Co_xFe_y ($y \le 20$, x+y=100)より、特に、y=50付近の組成において、磁歪定数 λ の値が大きいので、より大きな磁気弾性効果を発揮することができる。また、b c c 構造をとる Co_xFe_y ($y \ge 20$, x+y=100)は、保磁力が大きく、固定磁性層 23 の磁化固定を強固にすることができる。

[0106]

なお、本発明では、第1磁性層23aと非磁性金属層22の界面付近で、第1磁性層23aを構成する原子と、非磁性金属層22を構成する原子の大部分が互いに重なり合う整合状態になっていればよい。例えば、図3に模式的に示すように、一部に、第1磁性層23aを構成する原子と、非磁性金属層22を構成する原子が重なり合わない領域があってもよい。

[0107]

また、第2磁性層23cの材料には、bcc構造をとる Co_xFe_y ($y \ge 2$ 0, x+y=100)、fcc構造をとるCoまたは Co_xFe_y ($y \le 20$, x+y=100)のどちらを用いてもよい。

[0108]

第2磁性層 2 3 c の材料に、b c c 構造をとる Co_xFe_y ($y \ge 20$, x + y = 100) を用いると、正磁歪を大きくすることができる。b c c 構造をとる Co_xFe_y ($y \ge 20$, x + y = 100) は、保磁力が大きく、固定磁性層 2 3 の磁化固定を強固にすることができる。また、非磁性中間層 2 3 b を介した第 1 磁性層 2 3 a と第 2 磁性層 2 3 c 間のRKKY相互作用が強くなる。

[0109]

一方、第2磁性層23cは、非磁性材料層24に接しており、磁気抵抗効果に大きな影響を及ぼす層なので、fcc構造をとるCoまたはCo $_{\rm X}$ Fe $_{\rm y}$ ($_{\rm y}$ \leq 20, $_{\rm X}$ + $_{\rm y}$ = 100)を用いて形成すると磁気抵抗効果の劣化が少ない。

[0110]

図6ないし図8は、固定磁性層23の他の様態を示す部分断面図である。

図6に示されるように、固定磁性層23を構成する第1磁性層23aが、非磁性金属層22側にfcc磁性層23a1が設けられ、非磁性中間層側にbcc磁性層23a2が設けられたものであってもよい。

[0111]

f c c 磁性層 2 3 a 1 とは、面心立方格子(f c c)構造をとり、界面と平行な方向に 1 1 1 面として表される等価な結晶面が優先配向する磁性層であり、b c c 磁性層 2 3 a 2 とは、体心立方格子(b c c)構造をとり、界面と平行な方向に 1 1 0 面として表される等価な結晶面が優先配向している磁性層である

[0112]

f c c 磁性層 2 3 a 1 は、C o またはC o $_{x}$ F e $_{y}$ ($y \le 2$ 0, x + y = 1 0 0) を用いて形成され、b c c 磁性層 2 3 a 2 は、C o $_{x}$ F e $_{y}$ ($y \ge 2$ 0, x + y = 1 0 0) によって形成される。

[0113]

第1磁性層 2 3 a の非磁性中間層 2 3 b 側の界面付近を b c c 構造にすることにより、磁歪定数 λ の値を大きくし、大きな磁気弾性効果を発揮させることができる。また、非磁性中間層 2 3 b 側の組成が、 Co_XFe_y ($y \ge 20$, x+y=100) であると、非磁性中間層 2 3 b を介した第 1 磁性層 2 3 a と第 2 磁性層 2 3 c 間の R K K Y 相互作用が強くなる。

[0114]

一方、第1磁性層23aの非磁性金属層22側の界面付近をfcc構造にする と、固定磁性層23、非磁性材料層、フリー磁性層の結晶配向性が一定になり、 結晶粒も大きくなって磁気抵抗変化率(MR比)を高くすることができる。

[0115]

また、図7に示されるように、固定磁性層23を構成する第2磁性層23cは、非磁性材料層24側にfcc磁性層23c2が設けられ、非磁性中間層23b側にbcc磁性層23c1が設けられたものであってもよい。

[0116]

f c c 磁性層 2 3 c 2 とは、面心立方格子 (f c c) 構造をとり、界面と平行な方向に {1 1 1 } 面として表される等価な結晶面が優先配向する磁性層であり、 b c c 磁性層 2 3 c 1 とは、体心立方格子 (b c c) 構造をとり、界面と平行な方向に {1 1 0 } 面として表される等価な結晶面が優先配向している磁性層である

[0117]

f c c 磁性層 2 3 c 2 は、C o またはC o $_{x}$ F e $_{y}$ ($y \le 2$ 0, x + y = 1 0 0) を用いて形成され、b c c 磁性層 2 3 c 1 は、C o $_{x}$ F e $_{y}$ ($y \ge 2$ 0, x + y = 1 0 0) によって形成される。

[0118]

第2磁性層 2 3 c の非磁性中間層 2 3 b 側の界面付近を b c c 構造にすることにより、磁歪定数 λ の値を大きくし、大きな磁気弾性効果を発揮させることができる。また、非磁性中間層 2 3 b 側の組成が、 Co_XFe_Y ($y \ge 20$, x+y=100) であると、非磁性中間層 2 3 b を介した第1磁性層 2 3 a と第2磁性層 2 3 c 間の R K K Y 相互作用が強くなる。

[0119]

一方、第1磁性層23aの非磁性金属層22側の界面付近をfcc構造にすることによって、磁気抵抗効果の劣化を抑えることができる。

[0120]

または、図8に示されるように、固定磁性層23を構成する第1磁性層23aは、非磁性金属層22側にfcc磁性層23a1が設けられ、非磁性中間層側に bcc磁性層23a2が設けられたものであり、かつ、第2磁性層23cは、非磁性材料層24側にfcc磁性層23c2が設けられ、非磁性中間層23b側に bcc磁性層23c1が設けられたものであってもよい。

[0121]

なお、図6ないし図8では、第1磁性層23aをfcc磁性層23a1とbcc磁性層23a2とが積層された構造にし、または、第2磁性層23cを、bcc磁性層23c1とfcc磁性層23c2とが積層された構造にしている。

[0122]

しかし、本発明では、固定磁性層 2 3 の第 1 磁性層 2 3 a が、非磁性金属層 2 2 側の界面付近で、面心立方格子(f c c)構造をとり、界面と平行な方向に 1 1 1 面として表される等価な結晶面が優先配向し、非磁性中間層 2 3 b 側の界面付近で、体心立方格子(b c c)構造をとり、界面と平行な方向に、 1 1 0 面として表される等価な結晶面が優先配向していればよい。

[0123]

従って、固定磁性層 23 の第 1 磁性層 23 a は、非磁性金属層 22 側の界面付近でC o またはC o x F e y ($y \le 20$, x + y = 100) の組成を有し、f c c 構造をとり、界面と平行な方向に $\{1111\}$ 面として表される等価な結晶面が優先配向し、非磁性金属層 22 側の界面付近から非磁性中間層 23 b 側の界面に向かうに連れて、F e 濃度が徐々に大きくなって、非磁性中間層 23 b 側の界面付近で、C o x F e y ($y \ge 20$, x + y = 100) の組成を有し、体心立方格子(b c c)構造をとり、界面と平行な方向に、 $\{110\}$ 面として表される等価な結晶面が優先配向したものであってもよい。

[0124]

また、第2磁性層23cも同様に、非磁性材料層24側の界面付近から非磁性中間層23b側の界面に向かうに連れて、Fe濃度が徐々に大きくなるCoFe合金で形成されてよい。

[0125]

図9は、本発明の第2の実施の形態の磁気検出素子を記録媒体との対向面側から見た断面図である。

[0126]

図9に示された磁気検出素子は、図1に示された磁気検出素子に類似しており、多層膜T1の代わりに、多層膜T2が形成されている点で図1に示された磁気検出素子と異なっている。多層膜T2は、下から順にシードレイヤ21、フリー磁性層25、非磁性材料層24、第2磁性層23c、非磁性中間層23b、第1磁性層23aからなる固定磁性層23、非磁性金属層22、及び保護層26が積層されたものである。すなわち、多層膜T2は、多層膜T1の各層の積層順序を逆にしたものである。

[0127]

本実施の形態の磁気検出素子でも、固定磁性層23の第1磁性層23aが非磁性金属層22に接している。

[0128]

本実施の形態でも、非磁性金属層 2 2 の結晶構造は、成膜時の状態である面心 立方構造 (f c c) を維持しつづける。

[0129]

従って、非磁性金属層22を構成する原子と、固定磁性層23の第1磁性層2 3aを構成する原子とが互いに重なりあいやすくなり、非磁性金属層22内の結晶と第1磁性層23a内の結晶がエピタキシャルな整合状態になりやすくなる。

[0130]

しかも、第1磁性層23aの{111}面内または{110}面内の最近接原子間距離と、非磁性金属層22の{111}面内の最近接原子間距離には、一定以上の差が生じている。このため、第1磁性層23aと非磁性金属層22の界面付近では、第1磁性層23aを構成する原子と非磁性金属層22を構成する原子が互い

に重なり合いつつも、それぞれの結晶構造に歪みが生じる。従って、第1磁性層 23aの結晶構造に歪を生じさせることによって磁歪定数λを大きくさせること ができる。

[0131]

固定磁性層 2 3 の磁気弾性効果に基づく異方性を大きくするためには、多層膜 T 1 または T 2 に対して、バイアス下地層 2 7, 2 7、ハードバイアス層 2 8, 2 8、及び電極層 2 9, 2 9 からトラック幅方向に(図示 X 方向)に平行な方向 及び反平行な方向に加わる圧縮応力を大きくすることが好ましい。

[0132]

例えば、電極層 2 9, 2 9 が C r(クロム)、 α - T a、または R h τ 形成され、しかも電極層 2 9, 2 9 の結晶格子面の膜面平行方向の面間隔が C r の場合で 0. 2 0 4 4 n m以上(b c c 構造の $\{1\ 1\ 0\}$ 面間隔)、 α - T a の場合で 0. 2 3 3 7 n m以上(b c c 構造の $\{1\ 1\ 0\}$ 面間隔)、R h の場合で 0. 2 2 0 0 n m以上(f c c 構造の $\{1\ 1\ 1\}$ 面間隔)であると、多層膜 T 1 または T 2 に加わる 圧縮 応力を 大きくすることができる。このとき、図 2 に示される 矢印方向、すなわち 電極層 2 9, 2 9 の外側方向に向けて、電極層 2 9, 2 9 が延伸し、多層膜 T 1 または T 2 に対し、トラック幅方向に(図示 X 方向)に平行な 方向及 X 万向に X に

[0133]

電極層 2 9 , 2 9 の結晶格子面の膜面平行方向の面間隔は、X線回折や電子線回折によって測定することができる。なお、バルク状態のCr、 $\alpha-Ta$ 、またはRhは、結晶格子面の膜面平行方向の面間隔がCrの場合で0. 2 0 4 0 n m (b c c 構造の 1110 | 面間隔)、 $\alpha-Ta$ の場合で0. 2 3 3 2 n m (b c c 構造の 1110 | 面間隔)、Rhの場合で0. 2 1 9 6 n m (f c c 構造の 111 | 面間隔)であり、前記面間隔がこの値以上になると電極層 2 9 , 2 9 が 多層膜 T1に対し圧縮応力を与えるように作用する。

[0134]

電極層29,29をCrによって形成したときと、Auのような軟い金属材料によって形成したときとでは、前記圧縮応力に以下のような違いが生じる。

[0135]

例えば、下から順に、バイアス下地層:Cr (50Å) / ハードバイアス層:CoPt (200Å) / 中間層:Ta (50Å) / 電極層:Au (800Å) / 保護層:Ta (50Å) が積層された膜が生じさせる圧縮応力は、280MPa である。

[0136]

これに対し、下から順に、バイアス下地層: Cr (50Å) / ハードバイアス層: CoPt (200Å) / 中間層: Ta (50Å) / 電極層: Cr (1400Å) / 保護層: Ta (50Å) が積層された膜が生じさせる圧縮応力は、670MPaである。

[0137]

なお、中間層Ta(50Å)と保護層Ta(50Å)は図1には示されていないが、それぞれ、電極層の配向性を整える層と酸化防止層として機能する。

[0138]

なお、電極層 2 9, 2 9をスパッタ成膜するときには、イオンビームスパッタ法を用い、スパッタ装置内のAr、Xe、Kr などの圧力を $5\times10^{-3}\sim1\times10^{-1}$ (Pa) と小さくする。スパッタ装置内のAr、Xe、Kr などの圧力が小さいと、電極層を形成するCr、Ta、Rh 原子がAr 原子に衝突する確率が減少するので、Cr などの原子は高いエネルギーを保持したまま堆積していく。既に成膜されているCr などの膜に、ターゲットから飛来したなどのCr 原子が大きなエネルギーをもって衝突して埋め込まれていくと、電極層 2 9, 2 9 が外側方向に向けて延伸する。

[0139]

固定磁性層23のトラック幅方向の両端部はハードバイアス層28,28が発生する縦バイアス磁界によって磁化方向が傾きやすくなっている。しかし、固定磁性層23のトラック幅方向の両端部には大きな圧縮応力が加わる。従って、固定磁性層23のトラック幅方向の両端部は、磁気弾性効果による異方性が大きくなり、磁化方向が一方向に強く固定される。

$[0 \ 1 \ 4 \ 0]$

本発明は、固定磁性層 2 3 の両側からの圧縮応力と磁歪との関係に基づく一軸 異方性によって、固定磁性層 2 3 の磁化方向を固定するものであり、固定磁性層 にかかる圧縮応力は固定磁性層 2 3 の光学的トラック幅方向の両端部で強く、中 央部で弱い。従って、固定磁性層 2 3 の光学的トラック幅方向の幅寸法が大きい と、固定磁性層 2 3 の中央部付近の磁化方向固定力が小さくなる。従って、固定 磁性層 2 3 の光学的トラック幅寸法W1は、0.15 μ m以下であることが好ま しい。

[0141]

なお、フリー磁性層 2 5 の磁歪は負磁歪にすることが好ましい。上記したように、磁気検出素子の多層膜 T 1 には、両側から圧縮応力が加わっているので、負磁歪のフリー磁性層 2 5 は磁気弾性効果によって、トラック幅方向(図示 X 方向)に平行または反平行方向が磁化容易軸になりやすくなる。

[0142]

フリー磁性層 2 5 のトラック幅方向の両端部は反磁界によって磁化が不安定になりやすい。しかし、フリー磁性層 2 5 のトラック幅方向の両端部は、ハードバイアス層 2 8, 2 8 に近く、大きな圧縮応力が加わる。従って、フリー磁性層 2 5 のトラック幅方向の両端部は、磁気弾性効果による異方性が大きくなり、磁化方向が安定化する。

[0143]

従って、ハードバイアス層28,28の膜厚を小さくして、縦バイアス磁界を 小さくしてもフリー磁性層25を安定した単磁区状態にすることができる。ハー ドバイアス層28,28の膜厚を小さくして、縦バイアス磁界を小さくできると 、固定磁性層23のハイト方向への磁化固定状態を安定化できる。

[0144]

なお、フリー磁性層 2 5 の中央部付近の圧縮応力は、両端部の圧縮応力よりも 小さいので、磁界検出感度の低下を抑えることができる。

0 1 4 5

フリー磁性層 2 5 の磁歪定数 λ は、 $-8 \times 10^{-6} \le \lambda \le -0$. 5×10^{-6} の範囲であることが好ましい。また、ハードバイアス層 2 8, 2 8 の膜厚 t は 1

00Å≤t≤200Åであることが好ましい。フリー磁性層25の磁歪λが小さすぎると、或はハードバイアス層28,28の膜厚tが厚すぎると磁気検出素子の再生感度が低下する。一方、フリー磁性層25の磁歪λが大きすぎると、或はハードバイアス層28,28の膜厚tが薄すぎると磁気検出素子の再生波形に乱れが生じやすい。

[0146]

図1、図9に示された本実施の形態の磁気検出素子は、スパッタ法又は蒸着法による薄膜形成及びレジストフォトリゾグラフィーによるパターン形成によって製造される。スパッタ法及びレジストフォトリゾグラフィーは磁気検出素子を形成するときに、通常用いられる方法を使用する。

[0147]

ただし、第1磁性層23aを構成する原子と、非磁性金属層22を構成する原子とを互いに重なり合わせつつ、それぞれの結晶構造に歪みを生じさせるために、非磁性金属層22並びに第1磁性層23aを成膜するときには、例えば、以下の条件下で成膜することが好ましい。

DCマグネトロンスパッタ法

ターゲットへの入力電力:10~100W

Ar圧力: 0.01~0.5Pa

ターゲット/基板間距離:100~300mm

$[0\ 1\ 4\ 8]$

また、図1に示される磁気検出素子を形成するときには、非磁性金属層22を成膜するときの基板温度よりも非磁性層23aを成膜するときの基板温度が高くなるようにすると熱膨張の効果によって、より大きな整合歪みを生じさせることができる。図9に示される磁気検出素子を形成するときには、非磁性金属層22を成膜するときの基板温度を非磁性層23aを成膜するときの基板温度より高くなるようにすることが好ましい。

[0149]

多層膜T1の両側にハードバイアス層28,28が設けられた、図1の磁気検 出素子を形成後、ハイト方向に例えば1200(kA/m)の強磁場を印加して 、第1磁性層23a、第2磁性層23c、及びハードバイアス層28,28の磁化をハイト方向に向ける。その後、印加磁場を連続的に減少させ、第1磁性層23aと第2磁性層23cのスピンフロップ磁界より小さくして、第1磁性層23aと第2磁性層23cの磁化を互いに反平行方向に向ける。ハイト方向の磁場を取り去った後、さらに、トラック幅方向にハードバイアス層28,28の保磁力より大きな磁場を印加してハードバイアス層28,28を着磁する。

[0150]

トラック幅方向の磁場を除くと、固定磁性層23の第1磁性層23a及び第2磁性層23cの磁化は、主に磁気弾性効果によってハイト方向に反平行方向または平行方向を向く。また、フリー磁性層25はハードバイアス層28,28からの縦バイアス磁界によってトラック幅方向に単磁区化される。

[0151]

なお、固定磁性層23の成膜時にハイト方向の磁場を印加して、固定磁性層23の第1磁性層23a及び第2磁性層23cに、誘導異方性を付与してもよい。

[0152]

ただし、固定磁性層 2 3 の光学的トラック幅寸法W 1 が、0. 1 5 μ m以下になると(磁気弾性効果の影響が非常に大きくなる。特に本発明では、第 1 磁性層 2 3 a 及び第 2 磁性層 2 3 c の磁歪定数 λ 及びトラック幅方向に多層膜に加わる圧縮応力を大きくしているので、固定磁性層 2 3 の磁化の固定は主に磁気弾性効果によっている。

[0153]

本実施の形態では、多層膜 T 1、 T 2 の両側部にハードバイアス層 2 8, 2 8 と電極層 2 9, 2 9 の積層体が形成され、この積層体によって多層膜 T 1, T 2 に圧縮応力が加えられている。ただし、多層膜 T 1, T 2 の両側部にはハードバイアス層 2 8, 2 8 がなくてもよい。例えば、多層膜 T 1, T 2 の両側部に、軟磁性材料層と反強磁性層の積層体が設けられていてもよいし、多層膜 T 1, T 2 の両側部が絶縁層であってもよい。

[0154]

なお、本発明は、多層膜T1, T2の膜厚垂直方向にセンス電流が流されるト

ンネル型磁気抵抗効果素子やCPP-GMR型磁気検出素子に用いてもよい。この場合、電極層は、多層膜T1、T2の上下にそれぞれ形成されることになる。

[0155]

以上本発明をその好ましい実施例に関して述べたが、本発明の範囲から逸脱しない範囲で様々な変更を加えることができる。

[0156]

なお、上述した実施例はあくまでも例示であり、本発明の特許請求の範囲を限 定するものではない。

[0157]

【実施例】

PtMn層にCoFe層を積層し、PtMn層の組成比を変化させたときのCoFeの磁歪の変化を調べた。

[0158]

以下の多層膜を成膜し、290℃で4時間アニールした。

シリコン基板/アルミナ($1\ 0\ 0\ 0$ Å)/ ($N\ i\ 0.8$ $F\ e\ 0.2$) 60 $C\ r\ 40$ ($5\ 2$ Å)/ $P\ t\ _x$ $M\ n\ _100-x$ ($3\ 0$ Å)/ $C\ o\ _90$ $F\ e\ _{10}$ ($2\ 0$ Å)/ $R\ u\ (9\ Å)$

本実施例では、第2磁性層、非磁性材料層、フリー磁性層などを省略することによって、第1磁性層23aの磁歪を正確に測定するようにしている。

[0159]

磁歪の測定には光梃子法を用いた。レーザ光線を上記多層膜の表面に当てた状態で、前記多層膜の膜面平行方向に磁界を印加する。磁歪による多層膜の曲がりをレーザ光線の反射角度の変化として読み取り、多層膜の磁歪定数を検出する。

[0 1 6 0]

結果を図10に示す。図10に示されるように、PtMn層のPt濃度が高くなる程、多層膜の磁歪定数が大きくなる。特に、Pt濃度が51原子%以上になると、磁歪定数が急激に増加し、Pt濃度が55原子%以上になると磁歪定数の増加率が緩やかになる。

$[0 \ 1 \ 6 \ 1]$

これは、PtMn層のPt濃度が高くなる程、PtMnの結晶格子定数が大き

くなり、PtMn層とCoFe層の界面付近の歪みが大きくなるためであると考えられる。

[0162]

次に、PtMn層にCoFe層を積層したときと、PtMn層にCo層を積層したときのCo及びCoFeの磁歪定数を比較した。

[0 1 6 3]

以下の多層膜を成膜し、290℃で4時間アニールした。

シリコン基板/アルミナ($1\ 0\ 0\ 0\ A$)/($N\ i\ 0.8\ F\ e\ 0.2$) $60\ C\ r\ 40$ ($5\ 2\ A$)/ $P\ t\ 50\ M\ n\ 50$ ($0\ A$ または $3\ 0\ A$)/ $P\ i\ n\ 1$ ($X\ A$)/ $R\ u\ (9\ A$)/ $C\ u\ (8\ 5\ A$)/ $T\ a\ (3\ 0\ A$)(ただし、 $P\ i\ n\ 1\ tt\ C\ o\ 90\ F\ e\ 10$ または $C\ o\ b$))

磁歪の測定には光梃子法を用いた。

[0164]

結果を図11に示す。Pin1がCoであっても、CoFeであっても、PtMn層が下層にあるほうが、PtMn層がないものに比べて磁歪定数が大きくなっている。また、Pin1がCoであるほうが、CoFeであるものよりも磁歪定数が大きくなっている。

[0165]

また、Pin1をCoとし、Pin1の下層にPtMn層(30Å)を設けたとき、Pin1の膜厚を大きくしていくと、Pin1の膜厚が16Åから20Åの範囲で磁歪定数の増加が見られるが、Pin1の膜厚が20Åより大きくなると磁歪定数が減少している。

[0166]

これは、Pinlが厚くなりすぎると、PinlとPtMn層の界面付近に生じた歪みによる磁歪定数増大の効果が小さくなることを示している。

[0167]

次に、Pin1の上にPtMn層を形成して、Co及びCoFeの磁歪定数を 比較した。

[0168]

以下の多層膜を成膜し、290℃で4時間アニールした。

シリコン基板/アルミナ($1\ 0\ 0\ 0$ Å)/ ($N\ i\ 0.8$ F $e\ 0.2$) 60 C $r\ 40$ ($5\ 2$ Å)/C u ($8\ 5$ Å)/R u ($9\ Å$)/P i n 1 ($X\ Å$)/P t 50 M n 50 ($0\ Å$ または $3\ 0\ Å$)/T a ($3\ 0\ Å$) (ただし、P i n 1 は C $o\ 90$ F $e\ 10$ または C $o\)$

磁歪の測定には光梃子法を用いた。

[0169]

結果を図12に示す。Pin1の上にPtMn層を形成したときも、Pin1の下にPtMn層を形成したときの結果と同様の傾向をしめした。

[0170]

すなわち、Pin1がCoであっても、CoFeであっても、PtMn層が上層にあるほうが、PtMn層がないものに比べて磁歪定数が大きくなっている。また、Pin1がCoであるほうが、CoFeであるものよりも磁歪定数が大きくなっている。また、Pin1をCoとし、Pin1の上層にPtMn層(30Å)を設けたとき、Pin1の膜厚を大きくしていくと、Pin1の膜厚が16Åから20Åの範囲で磁歪定数の増加が見られるが、Pin1の膜厚が20Åより大きくなると磁歪定数が減少している。

[0171]

次に、積層人工フェリ構造の多層膜にPnMn層を重ねて磁歪を測定した。 以下の多層膜を成膜し、290℃で4時間アニールした。

シリコン基板/アルミナ($1000 \, \text{Å}$)/ $(\text{Ni}_{0.8}\text{Fe}_{0.2})_{60}\text{Cr}_{40}$ (52 Å)/Pt $_{50}\text{Mn}_{50}$ ($30 \, \text{Å}$)/Pin $_{1}$ ($16 \, \text{Å}$)/Ru($9 \, \text{Å}$)/Pin $_{2}$ ($40 \, \text{Å}$)/Cu($85 \, \text{Å}$)/Ta($30 \, \text{Å}$)(ただし、Pin $_{1}$ 、Pin $_{2}$ はCo $_{90}\text{Fe}_{10}$ 、Fe $_{50}\text{Co}_{50}$ またはCo)

[0172]

なお、本実施の形態では、Pin2層の厚さを現実的に好ましい厚さよりも厚く設定することによって、Pin1とPin2間のスピンフロップ磁界を大きくし、磁歪を測定しやすくしている。

[0173]

磁歪の測定にはベンディング法を用いた。ベンディング法とは、上記多層膜を 湾曲させて一軸性の歪みを与え、逆磁歪効果による一軸異方性の変化から磁歪定 数を測定する方法である。

[0174]

結果を表1に示す。

[0175]

【表1】

Pin1	ConFen	Со	Fe _{s0} Co _{s0}
Pin2	Co ₁₀ Fe ₁₀	Со	ConFen
λs(ppm)	+13.6	+54.4	+29.5

[0176]

この実験結果から、Pin1、Pin2がCoであるほうが、CoFeである ものよりも磁歪定数が大きくなることがわかる。

次に、非磁性金属層の膜厚を変化させたときの、Co及びCoFeの磁歪定数を 比較した。

[0177]

以下の多層膜を成膜し、290℃で4時間アニールした後、磁歪を測定した。 シリコン基板/アルミナ (1000Å) / (Ni_{0.8}Fe_{0.2}) ₆₀C r₄₀ (52 Å) /非磁性金属層/Pin1/Ru (9Å) /Pin2 (40Å) /Cu (8 5Å) /Ta (30Å)

[0178]

本実施例では、第2磁性層、非磁性材料層、フリー磁性層などを省略することによって、第1磁性層23aの磁歪を正確に測定するようにしている。

[0179]

なお、非磁性金属層=RuまたはPt50Mn50 (at%)、Pin1=Co、Co90Fe10 (at%) またはFe50Co50 (at%)、Pin2=Co、Co90Fe10 (at%) である。なお、以下において、Co90Fe10 (at%)を単に「CoFe」と、Fe50Co50 (at%)を単に「FeCo」と略記する。

[0180]

磁歪の測定にはベンディング法を用いた。ベンディング法とは、上記多層膜を 湾曲させて一軸性の歪みを与え、逆磁歪効果による一軸異方性の変化から磁歪定 数を測定する方法である。

[0181]

結果を図13に示す。この実験結果から、非磁性金属層がRuとPt50Mn50(at%)のいずれであっても、Pin1がCoまたはFeCoであるほうが、CoFeであるものよりも磁歪定数が大きくなることがわかる。CoFeはCoやFeCoに比べて、歪みが発生しても磁歪が変化しにくい材料であることがその理由であると考えられる。

[0182]

また、非磁性金属層が形成されたものは、非磁性金属層が形成されないものより磁歪定数が大きくなることもわかる。

[0183]

PinlがCoであるときは、非磁性金属層がRuとPt50Mn50 (at %) のいずれであっても同じくらい磁歪が増大する。

[0184]

Pin1がFeCoであるときは、非磁性金属層がPt50Mn50(at%)であるときのほうが、Ruであるときより、磁歪が増大する。

[0185]

なお、PinlがCoまたはFeCoであるとき、Pinlの膜厚が約5Å以上になると、膜厚が増加するにつれて磁歪定数が徐々に減少している。これは、非磁性金属層の膜厚が厚くなると、非磁性金属層とPinlの界面が非整合状態になりやすくなるためと考えられる。逆にいうと、非磁性金属層の膜厚が薄くなると、非磁性金属層の格子定数が変化しやすくなり、非磁性金属層とPinlの界面が歪みをともなう整合状態になりやすくなると考えられる。

[0186]

【発明の効果】

以上詳細に説明した本発明では、自己固定式の固定磁性層を有する磁気検出素

子において、固定磁性層の磁歪を制御する機構を明らかにし、前記固定磁性層に接する非磁性金属層の材料を適切に選択することによって、該磁歪を適切に制御して、固定磁性層の磁化を強固に固定することのできる磁気検出素子を提供できる。

[0187]

具体的には、前記固定磁性層を、複数の磁性層が非磁性中間層を介して積層されたものとし、前記複数の磁性層のうち前記非磁性材料層から最も離れた位置に形成されている第1の磁性層を、PtMn合金、または、X-Mn(ただしXは、Pt, Pd, Ir, Rh, Ru, Os, Ni, Fe のいずれか1種または2種以上の元素である)合金からなる前記非磁性金属層と接合させる。

[0188]

これにより、前記第1の磁性層の結晶構造に歪みを生じさせて前記第1の磁性層の磁歪定数 λ を大きくさせることができる。固定磁性層の磁歪定数を大きくすることによって磁気弾性エネルギーを大きくし、固定磁性層の一軸異方性を大きくできる。

[0189]

固定磁性層の一軸異方性が大きくなると、固定磁性層の磁化は一定の方向に強 固に固定され、磁気検出素子の出力が大きくなりかつ出力の安定性や対称性も向 上する。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1実施形態の磁気検出素子の構造を記録媒体との対向面側から見た断面図、

【図2】

図1に示された磁気検出素子の平面図、

【図3】

非磁性金属層と固定磁性層が整合しつつ、歪みが生じている状態を示す模式図、

図4

非磁性金属層と固定磁性層が整合している状態を示す模式図、

【図5】

非磁性金属層と固定磁性層が非整合している状態を示す模式図、

【図6】

本発明の磁気検出素子の固定磁性層付近の部分断面図、

【図7】

本発明の磁気検出素子の固定磁性層付近の部分断面図、

[図8]

本発明の磁気検出素子の固定磁性層付近の部分断面図、

【図9】

本発明の第2実施形態の磁気検出素子の構造を記録媒体との対向面側から見た断面図、

【図10】

PtMn層にCoFe層を積層し、PtMn層の組成比を変化させたときのCoFeの磁歪の変化を示すグラフ、

【図11】

PtMn層にCoFe層を積層したときと、PtMn層にCo層を積層したときのCo及びCoFeの磁歪定数を示すグラフ、

【図12】

CoFe層の上にPtMn層を積層したときと、Co層の上にPtMn層を積層したときのCo及びCoFeの磁歪定数を示すグラフ、

【図13】

非磁性金属層と強磁性層を積層した多層膜の磁歪を測定した結果を示すグラフ、

【図14】

従来の磁気検出素子の構造を記録媒体との対向面側から見た断面図、

【符号の説明】

- 20 下部ギャップ層
- 21 シードレイヤ
- 22 非磁性金属層
- 23 固定磁性層

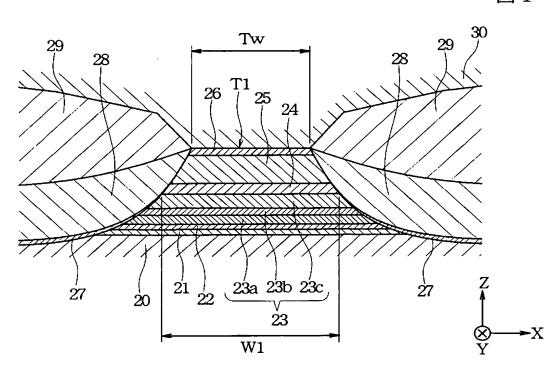
- 23a 第1磁性層
- 23b 非磁性中間層
- 23c 第2磁性層
- 24 非磁性材料層
- 25 フリー磁性層
- 2 6 保護層
- 27 バイアス下地層
- 28 ハードバイアス層
- 29 電極層
- 30 上部ギャップ層

【書類名】

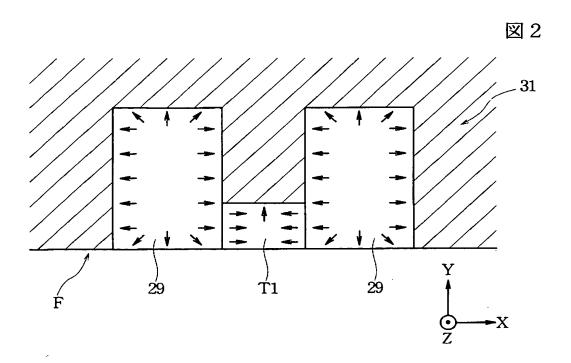
図面

【図1】

図 1



【図2】



【図3】

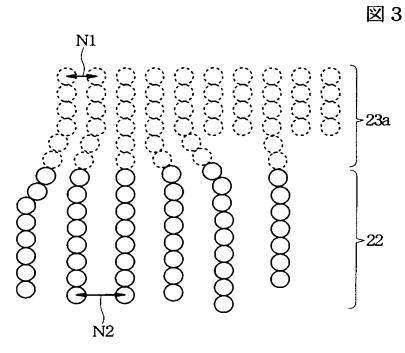


図 4

【図4】

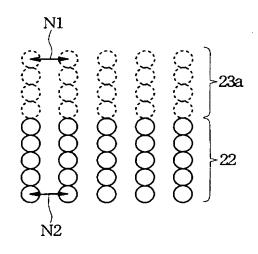
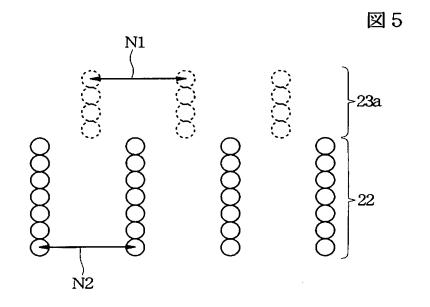
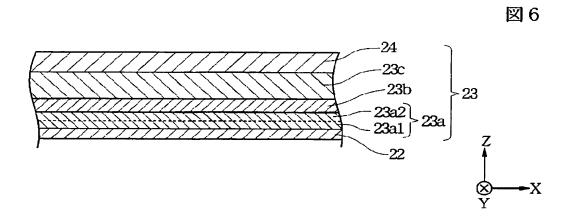


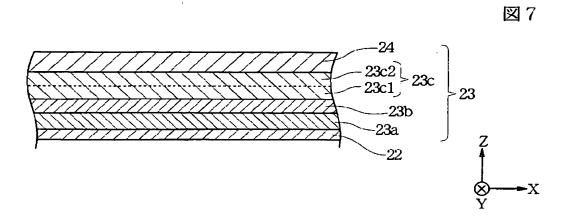
図5]



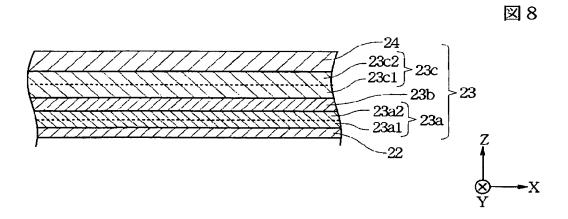
【図6】



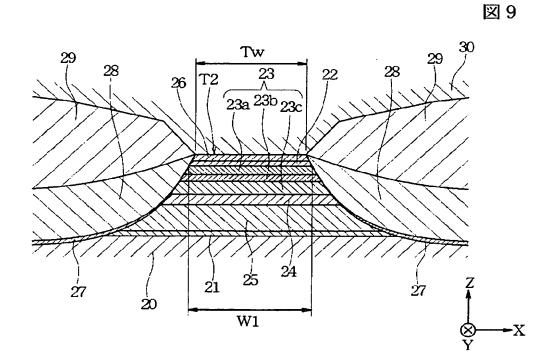
【図7】



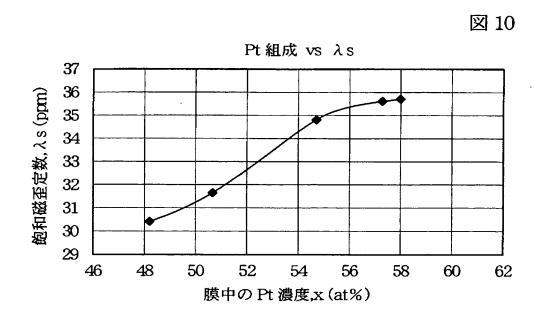
[図8]



【図9】

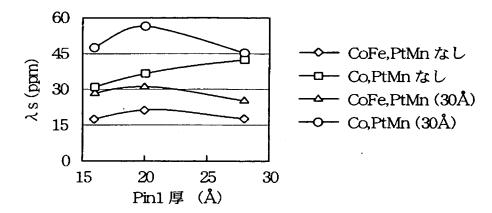


【図10】



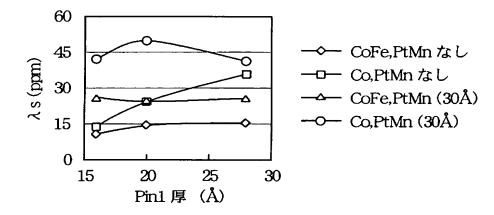
【図11】

図 11



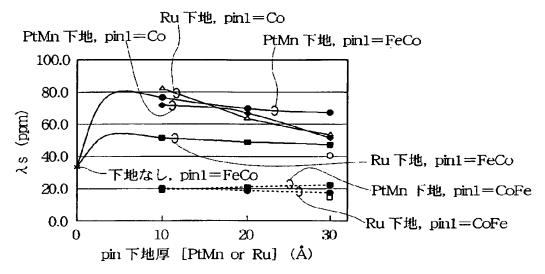
【図12】

図 12



【図13】

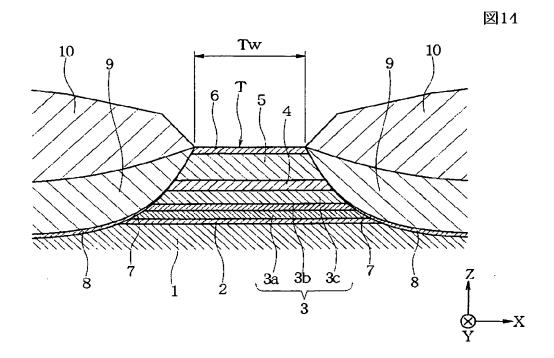
図 13



- → PtMn 下地, pin1=Co (22),pin2=Co (40)
- → Ru 下地, pin1=Co (22),pin2=Co (40)
- · PtMn 下地, pin1=CoFe (24), pin2=CoFe (40)
- ···· PtMn 下地, pin1=CoFe (18),pin2=CoFe (40)
- · · Ru 下地, pin1=CoFe (24), pin2=CoFe (40)
- * 下地なし、pin1=FeCo(16),pin2=Co(40)
- → PtMn 下地, pin1=FeCo(16),pin2=Co(40)
- → Ru 下地, pin1=FeCo(16),pin2=Co(40)
- o Ru下地, pin1=FeCo(12),pin2=Co(40)

(カッコ内膜厚 Å)

【図14】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 固定磁性層の磁化を、固定磁性層自体の一軸異方性によって固定する 磁気検出素子であって、固定磁性層の磁歪が大きく、磁気弾性効果の大きな磁気 検出素子を提供する。

【解決手段】

固定磁性層 2 3 の第 1 磁性層 2 3 a を非磁性金属層 2 2 の上に形成する。非磁性金属層 2 2 は、P t M n 合金、または、X — M n (ただしXは、P t , P d , I r , R h , R u , O s , N i , F e のいずれか 1 種または 2 種以上の元素である)合金からなるものである。第 1 磁性層 2 3 a を構成する原子と非磁性金属層 2 2 を構成する原子は互いに重なり合いつつも、それぞれの結晶構造に歪みが生じる。第 1 磁性層 2 3 a の結晶構造に歪を生じさせることによって磁歪定数 λ を大きくさせ、磁気弾性効果の大きな磁気検出素子を提供することができる。

【選択図】 図1

特願2003-048694

出願人履歴情報

識別番号

[000010098]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月27日 新規登録

変更理田」 住 所

東京都大田区雪谷大塚町1番7号

氏 名 アルプス電気株式会社